



中华人民共和国国家标准

GB/T 4721—92

印制电路用覆铜箔层压板通用规则

General rules for copper-clad laminated
sheets for printed circuits

1992-07-08 发布

1993-04-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

印制电路用覆铜箔层压板通用规则

GB/T 4721—92

General rules for copper-clad laminated sheets for printed circuits

代替 GB 4721—84

本标准参照采用国际标准 IEC 249《印制电路用覆金属箔基材》(1985~1988 年版)。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了覆铜箔层压板的有关术语、型号和命名、铜箔要求、外观、尺寸、试验方法、机械加工、检验规则、标志、包装、运输和贮存等共性要求。

本标准适用于印制电路用覆铜箔层压板(以下简称覆箔板)。

2 引用标准

- GB 1844 塑料及树脂缩写代号
- GB 2036 印制电路名词术语和定义
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)
- GB/T 4722 印制电路用覆铜箔层压板试验方法
- GB 4723 印制电路用覆铜箔酚醛纸层压板
- GB 4724 印制电路用覆铜箔环氧纸层压板
- GB 4725 印制电路用覆铜箔环氧玻璃布层压板
- GB 5230 电解铜箔

3 术语

- 3.1 覆铜箔面 copper-clad face
覆箔板的铜箔面。
- 3.2 粘合面 bonding surface
覆箔板蚀刻掉铜箔后的表面。
- 3.3 层压面 laminated surface
单面覆箔板没有覆铜箔的表面。
- 3.4 冷冲 cold punching
覆箔板在板温 20℃ 至 60℃ 之间进行的冲裁加工。
- 3.5 热冲 hot punching
覆箔板在板温超过 60℃ 时进行的冲裁加工。

4 型号和命名

- 4.1 产品型号第一个字母 C(铜),表示覆铜箔。

国家技术监督局 1992-07-08 批准

1993-04-01 实施